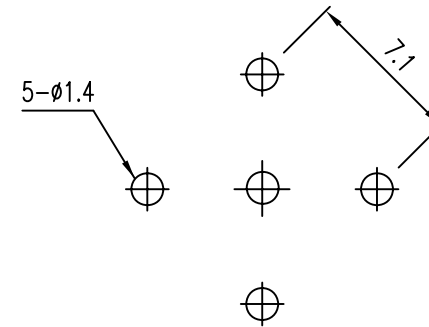
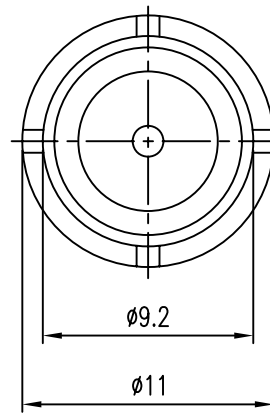
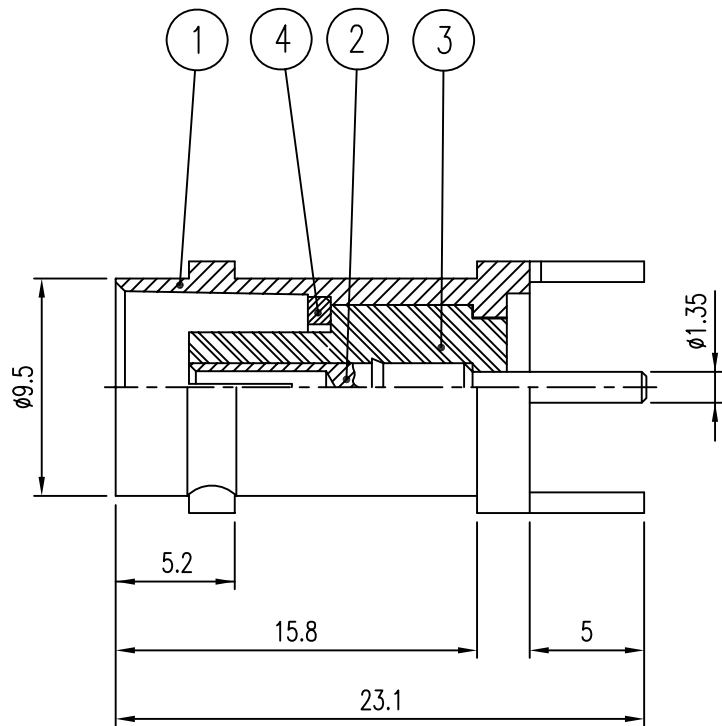
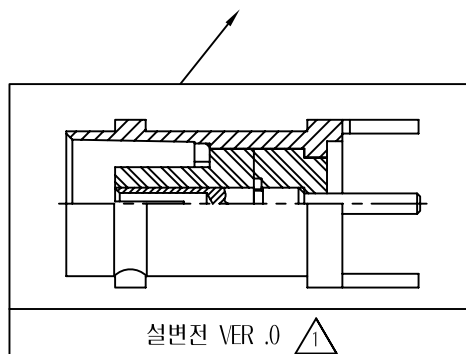


수 정 내 용									
부호	내 용					수정자	승인자	년 월 일	
1	[설번No.연구2007-165] 조립성 및 생산성 향상 (조립성 및 생산성 향상을 위한 구조변경)					김인철	윤상진	2007. 11. 6.	
2	[설번No.201807-0007] 조립성 개선으로 인한 조립공차 변경					은선영	김인철	2018. 07. 23.	



MOUNTING HOLE



4	고정 링	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00051-5/1 (L7009)
5	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	L6000
4	INSULATOR	1	TEFLON		H6078
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01086-N/1 (H6150) H6027
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01180-5/1 (E6145) E6028
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00683-5/1 (D6022)

대체가능재질		품 번		품 명		수량		재 질		표면처리		비 고	
공통공차		년월일 2000. 9. 5.						 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.					
* ±0.2 ±0.1		승인											
** ±0.1 ±0.05		검도						토벌 BNC50-J-4R-R VER.1					
재질		제도											
열처리		작성부서											
보호피막처리		적도 2/1		단위 mm		총량		A4		도번 CN00893-7/1 K325-456-000			